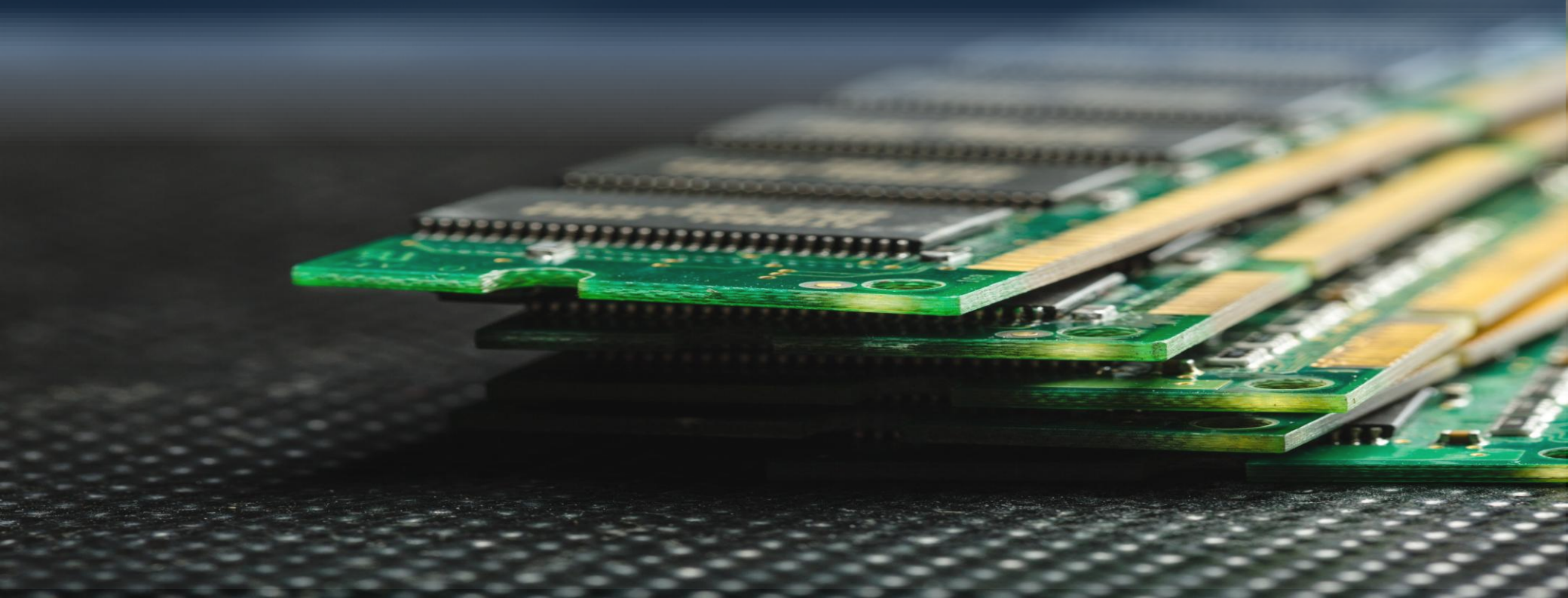




티엘비 2025년 3분기 경영실적 발표

2025.11.12

본 자료는 투자자의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 자료입니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발생하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며,
문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

티엘비의 미션

우리의 기술로 시작된 거대한 변화,
그 중심엔  Thin Lamination Board **TLB**가 있습니다.

티엘비 성장현황 및 미래전략

2011~2018

2019~2020

2021~2022

2023~

티엘비 1.0

티엘비 2.0 ~

PCB 벤처기업
중견 기업 선정

사업 고도화
IPO 상장

해외투자

사업확장 및
해외 사업 본격화

- 11년 06월 (주)티엘비 창립
11월 연구소 설립
- 13년 04월 TS 16949 인증
05월 ISO 9001/14001 인증
07월 TLB UL 승인
- 15년 05월 한국중견기업 연합회 정회원
- 16년 05월 중소기업청 표창장 수상
12월 1억불 수출탑 수상
- 17년 02월 삼성 Best Partner
Award 수상
07월 안전보건경영시스템
최우수 기업 선정
- 18년 05월 World Class 300 선정

- 19년
- 01월 삼성 Best Contribution
Award 수상 (2년 연속)
 - 04월 하이닉스 동반성장 협의회 가입
ISO 045001 인증 전환
 - 10월 제 18회 GSMA 안전경영부문
최우수상 수상 (2년 연속)
- 20년
- 12월 티엘비 코스닥 상장
하이닉스 동반성장 부문 대상

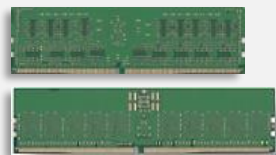
- 21년
- 03월 선도형 디지털 클러스터 선정
 - 04월 PSM 이행상태평가 S등급
 - 05월 혁신기업 국가대표 1000 선정
 - 11월 베트남 해외 법인 설립
- 22년
- 11월 하이닉스 Best Supplier
Award 수상
하이닉스 Best Partner
Award 수상
 - 12월 제 21회 GSMA 안전경영대상
대상 수상

- 23년
- 04월 코스닥 우량 기업 선정
 - 12월 은탑산업 훈장
통합환경 인허가 취득
- 24년
- 10월 베트남 공장 가동
 - 12월 안산 사무동 (8,000m²)
완공 및 입주 완료
- 25년
- 02월 AS9100 인증
 - 04월 ESG 경영수준 확인서
A+ 등급 취득

“티엘비 3.0”

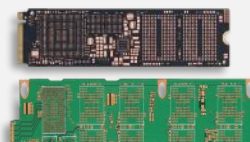
지속적인 차세대 제품 개발·선점으로 시장 경쟁력 강화

TLB 핵심 제품



Memory Module

DDR5 6400/7200 Mbps
DDR5 8000 Mbps



SSD Module

e-SSD
EDSFF

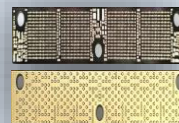
차세대 신제품



CXL

(Compute Express Link)

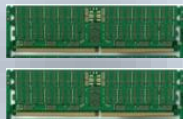
지정된 CPU에 메모리 제공할 뿐만 아니라,
지정되지 않은 CPU에 메모리 확장한 제품



SOCAMM

(Small Outline Compression Attached Memory Module)

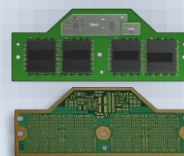
디지털, 아날로그, 혼합 신호 회로를 하나의 칩에
집적해 소형 고성능 저전력을 구현한 제품



MR-DIMM

(Multiplexed Rank DIMM)

여러 개 D램이 결합된 모듈 제품
랭크(Rank) 2개 동시 작동으로 속도 향상



LPCAMM

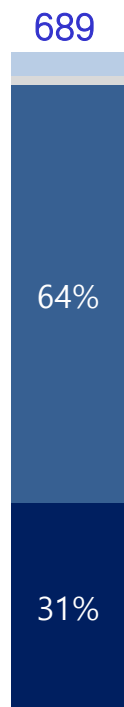
(Low Power Compression Attached Memory Module)

LPDDR 기반의 새로운 폼팩터로
전력을 최소화하여 열발생을 줄이는데 주로 사용

2025 3Q 주요 제품 매출 구성

2025년 3Q 매출 비중은 DDR5 64%, SSD 31%, ETC(신제품 포함) 5%로 구성되어 있음
Hi-end Server向 高부가 제품 매출 비중 꾸준히 확대되어 전체 매출 절반 이상, 3분기 연속 증가

■ SSD ■ DDR5 ■ DDR4 ■ ETC



“ 6400/7200 Mbps,
DDR5 전체 비중의 73% ”

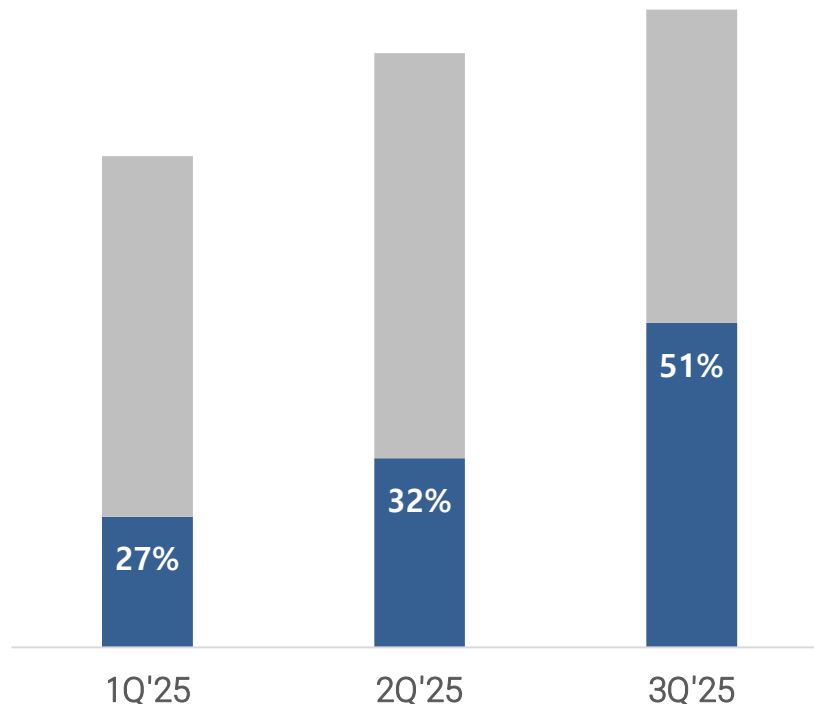
“ e-SSD,
SSD 비중의
28% ”

3Q'25

Hi-end Server向 高부가 제품 매출 비중

단위 : %

■ 高부가 제품 ■ 外

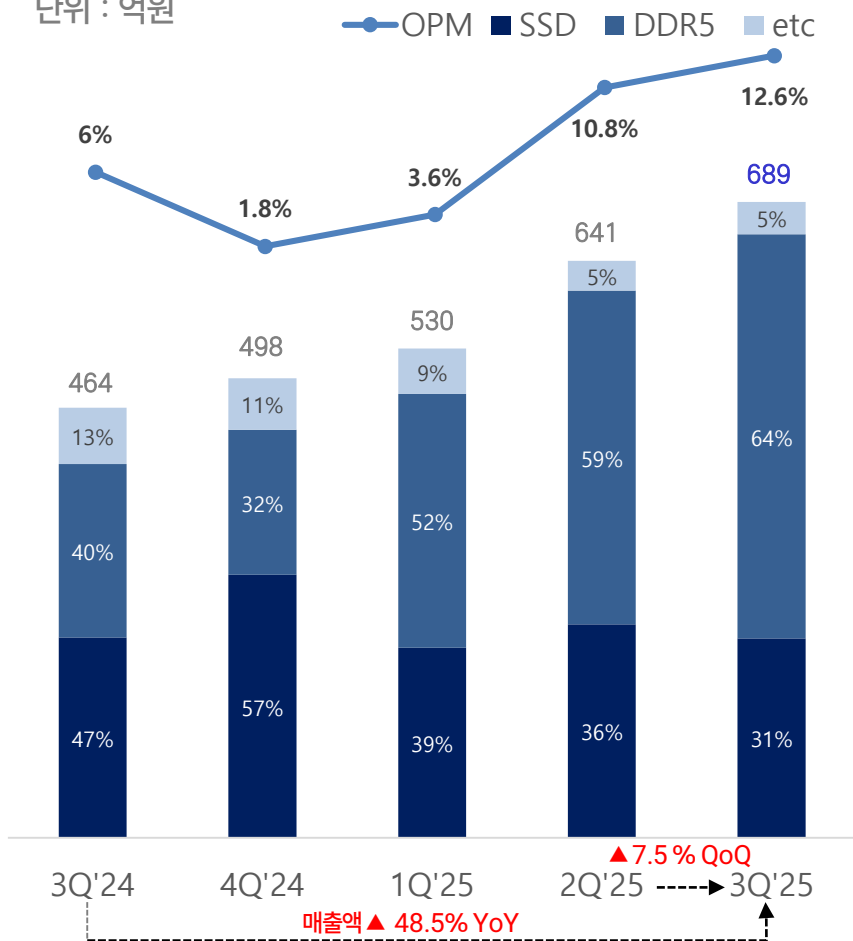


2025 3Q 경영성과

2025년 3Q 매출액 689억원(▲7.5% QoQ, ▲48.5% YoY), 영업이익 87억원(▲26.1% QoQ)
OPM 12.6% 달성, 안정적인 성장 추세 속 2분기 연속 매출 최고치 경신

분기별 매출

단위 : 억원



3Q25 현황

- 창사 이래 최대 실적, 2분기 연속 달성 → 성장 모멘텀 입증
- Hi-end Server向 高부가 제품 비중 50% 돌파

DDR5

3Q25 ▲133% YoY, ▲21% QoQ
QoQ 대비 5%p 증가, YoY 대비 24%p 증가

SSD

3Q25 ▼1% YoY, ▼6% QoQ 으로 소폭 줄었으나
데이터센터 및 AI 인프라 확대에 e-SSD 매출 ▲21% QoQ

4Q'25 전망

- 2025년 4분기 연속 매출 성장 전망
- DDR5 위주의 Hi-end Server向 高부가 제품 지속 확대

25년 3분기 경영실적 및 재무현황

요약 연결 손익 분석

(단위 : 억원)	2023	2024	3Q'24	2Q'25	3Q'25	QoQ	YoY
매출액	<u>1,713</u>	<u>1,800</u>	<u>464</u>	<u>641</u>	<u>689</u>	<u>48</u>	<u>225</u>
매출원가	1,600	1,659	409	544	569	25	160
매출총이익	<u>114</u>	<u>141</u>	<u>55</u>	<u>96</u>	<u>120</u>	<u>24</u>	<u>65</u>
판매비와관리비	83	107	27	28	33	5	6
영업이익	<u>30</u>	<u>34</u>	<u>28</u>	<u>69</u>	<u>87</u>	<u>18</u>	<u>59</u>
금융수익	10	7	2	1	1	0	(1)
금융비용	13	18	5	7	6	(1)	1
기타수익	24	34	1	8	6	(2)	5
기타비용	19	12	5	16	0	(16)	(5)
법인세차감전순이익	<u>33</u>	<u>49</u>	<u>13</u>	<u>56</u>	<u>87</u>	<u>31</u>	<u>74</u>
법인세비용	8	13	5	11	21	10	16
(당기)순이익	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>8</u>	<u>45</u>	<u>65</u>	<u>20</u>	<u>57</u>

25년 3분기 경영실적 및 재무현황

요약 연결 재무 상태표

(기본 단위 : 억원)	3Q'24	2Q'25	3Q'25
자산총계	1,789	2,005	2,248
유동자산	655	842	1,170
현금 및 현금성 자산	148	159	365
재고자산	238	315	378
비유동자산	1,134	1,163	1,077
부채총계	684	867	1,040
유동부채	413	773	947
비유동부채	271	94	93
자본총계	1,106	1,138	1,207
자본금	49	49	49

주요 수익성 지표

(기본 단위 : %)	3Q'24	2Q'25	3Q'25
OPM	6%	10.8%	12.6%
매출액 순이익률(순이익/매출)	0.02	0.07	0.09
총자산 회전율(매출/총자산)	<u>0.26</u>	<u>0.32</u>	<u>0.31</u>
재무 레버리지(총자산/총자본)	1.62	1.76	1.86
부채 비율(총부채/총자본)	0.62	0.76	0.86
EBITDA 마진	10%	14%	16%

❖ 해당 보고서에 기재된 EBITDA 마진은 단일 분기 기준 수치임

Core Business Partners





경기도 안산시 단원구 신원로 305(목내동) 16BL 17LT

IR 관련 문의 : purple@tlbpcb.com

www.tlbpcb.com